

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《關於使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》及其附件，僅供參閱。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事長兼執行董事  
張素心先生

中國上海，二零二三年九月二十日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事：**

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

**非執行董事：**

孫國棟

葉峻

**獨立非執行董事：**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

A 股代码：688347  
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司  
港股简称：华虹半导体

公告编号：2023-005

# 华虹半导体有限公司

## 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称“华虹宏力”）
- 投资金额：126.3235 亿元人民币（拟使用募集资金对全资子公司华虹宏力进行增资）
- 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资事项无需提交股东大会审议。

公司董事会于 2023 年 9 月 19 日审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司华虹宏力增资 126.3235 亿元人民币（以下币种无特别说明，均为人民币）。联席保荐人国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司对前述事项出具了明确同意的核查意见。本次使用募集资金向全资子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 28,232.30 万元（含税）后，募集资金净额

为 2,092,067.70 万元，上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第 60985153\_B02 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与联席保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

公司在《华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：

单位：亿元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	拟使用募集资金比例
1	华虹制造（无锡）项目	125.00	69.44%
2	8英寸厂优化升级项目	20.00	11.11%
3	特色工艺技术创新研发项目	25.00	13.89%
4	补充流动资金	10.00	5.56%
合计		<b>180.00</b>	<b>100.00%</b>

本次公司向华虹宏力增资的 126.3235 亿元募集资金中，部分募集资金将用于华虹宏力向华虹制造（无锡）项目的实施主体华虹半导体制造（无锡）有限公司增资<sup>1</sup>，其余募集资金将用于 8 英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金。

## 三、使用募集资金向华虹宏力增资情况

### （一）华虹宏力基本情况

公司名称	上海华虹宏力半导体制造有限公司
注册资本	7,828,577,758.51元（本次增资前）
法定代表人	张素心
成立日期	2013年1月24日
统一社会信用代码	91310000057674532R
注册地/主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1399号

<sup>1</sup>为免疑义，华虹制造（无锡）项目剩余的拟使用募集资金部分将由公司直接向华虹半导体制造（无锡）有限公司进行增资。

经营范围	集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	本次增资前后，华虹宏力均为公司持股100%的全资子公司

## （二）向华虹宏力增资情况

根据公司 2023 年 9 月 19 日董事会决议，公司拟使用 126.3235 亿元募集资金向华虹宏力注资，增资后，华虹宏力的注册资本增加至 20,460,927,758.51 元。

## 四、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的需要，公司本次增资的资金来源为公司募集资金，公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、本次增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。

## 六、专项意见说明

经核查，联席保荐人认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求；公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2023年9月21日

# 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

## 关于华虹半导体有限公司

### 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称“联席保荐人”）作为华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华虹公司拟使用募集资金向全资子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称“华虹宏力”）增资实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股，每股发行价格为人民币52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计28,232.30万元（含税）后，募集资金净额为2,092,067.70万元，上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第60985153\_B02号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与联席保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于2023年8月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华虹公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	拟使用募集资金比例
1	华虹制造（无锡）项目	125.00	69.44%
2	8英寸厂优化升级项目	20.00	11.11%
3	特色工艺技术创新研发项目	25.00	13.89%
4	补充流动资金	10.00	5.56%
合计		180.00	100.00%

本次公司向华虹宏力增资的126.3235亿元募集资金中，部分募集资金将用于华虹宏力向华虹制造（无锡）项目的实施主体华虹半导体制造（无锡）有限公司增资<sup>1</sup>，其余募集资金将用于8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金。

## 三、使用募集资金向华虹宏力增资情况

### （一）华虹宏力基本情况

公司名称	上海华虹宏力半导体制造有限公司
注册资本	7,828,577,758.51元（本次增资前）
法定代表人	张素心
成立日期	2013年1月24日
统一社会信用代码	91310000057674532R
注册地/主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1399号
经营范围	集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	本次增资前后，华虹宏力均为公司持股100%的全资子公司

### （二）华虹制造增资情况

<sup>1</sup> 为免疑义，华虹制造（无锡）项目剩余的拟使用募集资金部分将由公司直接向华虹半导体制造（无锡）有限公司进行增资。

根据公司2023年9月19日董事会决议，公司拟使用126.3235亿元募集资金向华虹宏力注资，增资后，华虹宏力的注册资本增加至20,460,927,758.51元。

#### **四、本次增资对公司的影响**

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的需要，公司本次增资的资金来源为公司募集资金，公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **五、本次增资后的募集资金管理**

为确保募集资金使用安全，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。

#### **六、本次增资审议程序**

公司董事会于2023年9月19日审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。本次增资事项符合募集资金使用计划的安排，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### **七、联席保荐人核查意见**

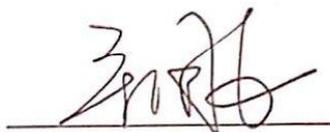
经核查，联席保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求；公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投

项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

综上，联席保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

(此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于华虹半导体有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



寻国良



李 淳

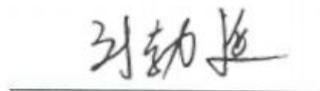


（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于华虹半导体有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



鄂凯丞



刘勃延



2023年9月20日